

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0522)

截至二零二三年三月三十一日止三個月之 第一季度未經審核業績公布

宏觀經濟儘管充滿挑戰
二零二三年第一季度銷售收入依然高於預測之中位數

集團財務概要: 二零二三年第一季度

- * 銷售收入為港幣 39.2 億元(5.00 億美元)，按年-25.6%，按季亦-9.5%
- * 新增訂單總額為港幣 35.5 億元(4.53 億美元)，按年-49.7%，按季則+13.8%
- * 毛利率為 40.4%，按年-21 點子，按季亦-98 點子
- * 經營利潤率為 11.9%，按年-717 點子，按季亦-181 點子
- * 盈利為港幣 3.15 億元，按年-62.0%，按季則+18.2%
- * 每股基本盈利為港幣 0.77 元，按年-61.9%，按季則+18.5%

二零二三年第二季度銷售收入預測

- * 將介乎 4.55 億美元至 5.25 億美元之間，以其中位數計按年-26.2%，按季亦-2.0%

ASMPT Limited 董事會欣然宣布集團截至二零二三年三月三十一日止三個月之未經審核業績如下：

業績摘要

ASMPT Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零二三年三月三十一日止三個月（「二零二三年第一季度」）錄得銷售收入為港幣39.2億元(5.00億美元)，較二零二二年第一季度銷售收入按年減少25.6%。集團於二零二三年第一季度綜合除稅後盈利為港幣3.15億元，較去年度同期盈利港幣8.30億元減少62.0%。二零二三年第一季度每股基本盈利為港幣0.77元，二零二二年第一季度為港幣2.02元。

管理層討論及分析

二零二三年第一季度業務回顧將由集團表現最亮麗的業務開始解說，接著是集團及其分部，即半導體解決方案分部（「SEMI」）及SMT解決方案分部（「SMT」）的財務回顧。

二零二三年第一季度集團業務摘要

於二零二三年第一季度，消費意欲持續疲弱，但集團受惠於自身獨特且廣泛的產品組合所帶來的多元化業務模式，為集團帶來業務韌性及競爭優勢。主要由其 SMT 業務所推動，集團的銷售收入高於預測的中位數。SMT 佔集團總銷售收入的比例亦已連續三個季度高於 SEMI，後者繼續受行業低迷所帶來的影響。

集團的新增訂單總額較二零二二年第四季度增加約 14%，SEMI 於二零二三年第一季度的新增訂單總額有所增加，而 SMT 於本季度在整體 SMT 市場放緩的情況下仍能保持高水平的新增訂單總額。

集團的毛利率亦已連續八個季度高於 40%，突顯集團在不同行業周期中仍能維持平穩的毛利率。

集團的汽車終端市場應用繼續佔集團總銷售收入最高比例。由於在汽車電動化的趨勢下，每輛汽車的矽及電子含量增加，集團的解決方案，包括燒結、激光切割及塑封成型受到青睞。集團為更多電動車企業提供一系列解決方案，有助提升集團在汽車領域的實力。

SMT 表現強健

受惠於汽車及工業終端市場應用的表現持續強勁，SMT 強勁的新增訂單總額及銷售收入體現於分部強健的表現。集團堅信，其 SMT 於二零二三年第一季度已成功擴大市場佔有率，並佔據了領導地位。

先進封裝

集團擁有業內最全面的先進封裝（「AP」）解決方案，使其得以滿足廣泛應用領域的不同需求。

管理層討論及分析（續）

生成式人工智能應用領域已引起企業和消費者的關注，而這股「人工智能大趨勢」將有利於圖像處理器／中央處理器（GPU/CPU）和高頻寬記憶體（「HBM」）解決方案供應商，以支持人工智能應用對計算及記憶體能力幾何級增長的需求。就此集團已準備就緒，以接收更多用於HBM應用相關之熱壓焊接（「TCB」）設備的訂單。

集團預期未來對其 TCB 設備的需求將繼續保持強勁，部分原因由人工智能應用的演變所帶動。隨著異構集成架構變得更加複雜，因此組件之間有更多的「互聯」。平衡了準確性和成本的 TCB 設備是目前在大多數此類互聯中的首選設備。

集團亦擴大其全球外判裝嵌及測試商（OSAT）TCB 客戶基礎，向首屈一指的全球晶圓代工客戶交付首批新一代環保、超微間距的晶片與晶圓 TCB 設備。

此外，集團正按計劃向其主要客戶交付用於各種應用的混合焊接（「HB」）設備。本季度集團已經取得突破性進展，贏得首宗將用於 3D 集成的 HB 設備之客戶訂單。計劃將於明年向該客戶交付。

二零二三年第一季度集團財務回顧

(港幣百萬元)	二零二三年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	3,545.8 (4.53 億美元)	+13.8%	-49.7%
銷售收入	3,917.5 (5.00 億美元)	-9.5%	-25.6%
毛利率	40.4%	-98 點子	-21 點子
經營利潤率	11.9%	-181 點子	-717 點子
盈利	315.1	+18.2%	-62.0%
盈利率	8.0%	+189 點子	-772 點子

二零二三年第一季度的銷售收入為港幣 39.2 億元，按季減少 9.5%。SEMI 及 SMT 的銷售收入均按季減少。由於半導體下行週期持續，SEMI 的銷售收入跌幅較大。

集團的新增訂單總額由二零二二年第四季度的低位回升至二零二三年第一季度的約港幣 35.5 億元（4.53 億美元），按季增加 13.8%。新增訂單總額增長主要受汽車終端市場的強勁需求所推動。於二零二三年三月三十一日，集團的未完成訂單總額為 11.1 億美元。

集團的毛利率為 40.4%，按季減少 98 點子，主要由於 SMT 分部組合佔集團銷售收入的百分比達 60%以上。

集團的經營利潤率為 11.9%，按季減少 181 點子，主要由於銷售減少所致。

集團的盈利為港幣 3.15 億元，按季增加 18.2%，是基於二零二二年第四季度盈利受不利的外匯影響。

於二零二三年三月三十一日，集團的流動資金狀況穩健，現金及銀行存款總額為港幣 39.9 億元，而銀行借款則減少至港幣 20 億元。因此，現金及銀行存款淨額維持在港幣 19.9 億元的穩健水平。

管理層討論及分析 (續)

二零二三年第一季度半導體解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二三年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	1,502.3 (1.92 億美元)	+33.6%	-63.5%
銷售收入	1,541.1 (1.97 億美元)	-18.1%	-47.6%
毛利率	45.1%	+66 點子	+37 點子
分部盈利	38.1	-66.6%	-93.9%
分部盈利率	2.5%	-359 點子	-1,876 點子

SEMI 分部的銷售收入為港幣 15.4 億元 (1.97 億美元)，按季減少 18.1%，佔集團季度總銷售收入的 39.3%。該分部銷售收入的表現主要受以下各業務單位的發展影響：

- (i) 因為對主流設備的需求持續疲弱，集成電路／離散器件業務單位的銷售收入按季減少。汽車終端市場的銷售收入為貢獻最多的業務單位。
- (ii) 光電業務單位的銷售收入按季減少。業務單位的銷售收入主要受汽車、矽光子及先進顯示屏的高端應用所推動。
- (iii) CIS 業務單位的銷售收入按季錄得增長，但由於全球智能手機市場持續疲弱，因此依然處於較低水平。

此分部於二零二三年第一季度的新增訂單總額為港幣 15.0 億元 (1.92 億美元)，較二零二二年第四季度較低基數高 33.6%，汽車及 AP 為主要貢獻來源。

於二零二三年第一季度分部毛利率為 45.1%，按季增加 66 點子，主要受惠於有利的產品組合及持續的成本控制措施。

二零二三年第一季度 SMT 解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二三年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	2,043.5 (2.61 億美元)	+2.6%	-30.2%
銷售收入	2,376.4 (3.03 億美元)	-2.9%	+2.2%
毛利率	37.4%	-168 點子	+193 點子
分部盈利	480.1	-8.9%	+9.7%
分部盈利率	20.2%	-132 點子	+137 點子

SMT 分部的銷售收入繼續表現強勁，佔集團二零二三年第一季度的總銷售收入 60.7%，為港幣 23.8 億元 (3.03 億美元)，按季微跌 2.9%。SMT 的銷售收入表現主要由工業和汽車應用所推動，需求主要來自歐洲。

SMT 新增訂單總額亦主要受汽車和工業終端市場所推動，於二零二三年第一季度按季增加 2.6% 至港幣 20.4 億元 (2.61 億美元)。

二零二三年第一季度分部毛利率為 37.4%，因產品組合按季減少 168 點子。

管理層討論及分析（續）

前景

雖然汽車及工業等行業造好，但宏觀經濟環境的消費信心依然疲弱。此外，近期銀行業出現的動盪，以及持續的通脹，均令整體市況不明。這些都為全球整體經濟前景增添了不確定性。

基於上述外部環境，集團預計二零二三年第二季度的銷售收入將介乎 4.55 億美元至 5.25 億美元之間，以中位數計按年及按季分別減少 26.2%和 2.0%。

長遠而言，憑藉其獨特且廣泛的產品組合，集團對其前景及增長潛力依然保持樂觀，相信長期結構性趨勢，包括汽車電動化、智能工廠、綠色基建、5G、物聯網和生成式人工智能增長所推動的高性能計算，將繼續支持行業的發展。

簡明綜合損益表

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
	<i>附註</i>		
銷售收入	2	3,917,493	4,330,434
銷貨成本		(2,333,873)	(2,537,471)
毛利		<u>1,583,620</u>	<u>1,792,963</u>
其他收入		28,080	27,833
銷售及分銷費用		(390,195)	(415,940)
一般及行政費用		(241,737)	(259,208)
研究及發展支出		(485,904)	(524,467)
其他收益及虧損		(23,666)	(196,762)
其他支出		(7,844)	(31,695)
財務費用		(29,381)	(29,555)
合營公司業績持份		11,417	13,367
除稅前盈利		<u>444,390</u>	<u>376,536</u>
所得稅開支		(129,262)	(225,243)
本期間盈利		<u><u>315,128</u></u>	<u><u>266,566</u></u>
以下各方本期間應佔盈利(虧損):			
本公司持有人		317,887	266,876
非控股權益		(2,759)	(310)
		<u><u>315,128</u></u>	<u><u>266,566</u></u>
每股盈利	3		
- 基本		港幣 0.77 元	港幣 0.65 元
- 攤薄		港幣 0.77 元	港幣 2.02 元

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	315,128	266,566	830,160
其他全面收益(支出)			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 界定福利退休計劃的除稅後重新計量	-	75,403	-
- 其他全面收益以公平價值列賬的權益 性工具投資之公平價值收益(減值) 淨額	245	(35,279)	-
	245	40,124	-
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 換算海外營運公司匯兌差額:			
- 附屬公司	247,285	514,819	(45,462)
- 合營公司	12,582	1,319	4,713
- 被指定對沖現金流的對沖工具之 公平價值(減值)收益	(17,201)	(9,735)	42,625
	242,666	506,403	1,876
本期間其他全面收益	242,911	546,527	1,876
本期間全面收益總額	558,039	813,093	832,036
以下各方本期間應佔全面收益(支出)總額:			
本公司持有人	557,495	811,364	832,768
非控股權益	544	1,729	(732)
	558,039	813,093	832,036

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，惟於各報告期期末按公平價值計量之若干金融工具除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團現有兩個（二零二二年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二二年：兩個）主要產品系列。

本集團以可報告之經營分部分析之銷售收入及業績如下：

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
對外客戶分部銷售收入			
半導體解決方案	1,541,099	1,882,683	2,942,583
表面貼裝技術解決方案	2,376,394	2,447,751	2,324,831
	3,917,493	4,330,434	5,267,414
分部盈利			
半導體解決方案	38,096	114,127	624,662
表面貼裝技術解決方案	480,114	526,794	437,830
	518,210	640,921	1,062,492
利息收入	19,295	15,156	5,439
財務費用	(29,381)	(29,555)	(29,426)
合營公司業績持份	11,417	13,367	49,109
未分配其他收入	5,186	5,257	5,914
未分配外幣淨匯兌(虧損)收益及 外幣遠期合約的公平價值變動	(24,302)	(197,666)	31,404
未分配一般及行政費用	(48,416)	(41,815)	(53,637)
未分配其他收益及虧損	225	2,566	(412)
其他支出	(7,844)	(31,695)	(15,480)
除稅前盈利	444,390	376,536	1,055,403
分部盈利之百分比			
半導體解決方案	2.5%	6.1%	21.2%
表面貼裝技術解決方案	20.2%	21.5%	18.8%

3. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利 (本公司持有人應佔之本期間盈利)	317,887	266,876	832,335
	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二二年 十二月三十一日 止三個月 股份之數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)
計算每股基本盈利之普通股加權平均 股數	412,504	410,126	412,695
潛在攤薄影響之股數：			
- 僱員股份獎勵計劃	2	2,555	121
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均 股數	412,506	412,681	412,816

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二三年三月三十一日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二三年四月二十五日

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)